


Dell™ Studio XPS™ 8000 Especificações completas

Este documento fornece informações que são necessárias ao instalar, atualizar drivers e aprimorar o seu computador.

NOTA: as ofertas podem variar por região. Para obter mais informações relativas à configuração do seu computador, clique em **Iniciar**  **Ajuda e suporte** e selecione a opção para exibir as informações sobre o computador.

Processador	Conectores da placa de sistema
Unidades e dispositivos	Conectores externos
Memória	Slots de expansão
Informações do computador	Alimentação
Barramento de expansão	Bateria
Video	Características físicas
Áudio	Ambiente do computador
Leitor de placa de memória	

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução deste material sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais mencionadas neste texto: *Dell*, o logotipo *DELL* e *Studio XPS* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Intel* é uma marca comercial registrada e *Core* é uma marca comercial da Intel Corporation nos EUA e em outros países; *Blu-ray Disc* é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association; *Bluetooth* é uma marca comercial registrada de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e é usada pela Dell sob licença.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser utilizados neste documento como referência às entidades proprietárias dessas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas e nomes de terceiros.

Modelo: série D03M

Tipo: D03M001

Agosto de 2009

Rev. A00

Processador

Tipo	Intel® Core™ i7-870 Intel Core i7-860 Intel Core i5-750
Cache L1	32 kB
Cache L2	256 kB
Cache L3	8 MB

[Voltar ao topo](#)

Unidades e dispositivos

Acessíveis externamente	<ul style="list-style-type: none"> dois compartimentos de 5,25 polegadas para unidade de DVD+/-RW SATA Super Multi Drive, Blu-ray Disc™ combo ou Blu-ray Disc RW um compartimento de 3,5 polegadas para um módulo Flexdock ou Bluetooth®
-------------------------	--

Sem fio (opcional)	tecnologia sem fio WiFi/Bluetooth®
Acessíveis internamente	dois compartimentos de 3,5 polegadas para discos rígidos SATA

[Voltar ao topo](#)

Memória

Conectores	quatro soquetes DIMM DDR3 acessíveis internamente
Capacidades	1 GB, 2 GB e 4 GB
Tipo de memória	memória DIMM DDR3 de 1066 MHz ou 1333 MHz; somente não-ECC
Configurações possíveis de memória	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB (sistema operacional de 64 bits)

[Voltar ao topo](#)

Informações do computador

Chipset do sistema	Intel P55
Largura do barramento de dados	2,5 GT/s
Largura do barramento DRAM	64 bits
Largura do barramento de endereços do processador	64 bits
Suporte para RAID (somente unidades SATA internas)	RAID 0 (particionamento) RAID 1 (espelhamento)
Chip BIOS (NVRAM)	8 MB
Velocidade da memória	1333 MHz

[Voltar ao topo](#)

Barramento de expansão

PCI Express	<ul style="list-style-type: none"> slot Gen2 x1, velocidade bidirecional — 500 MB/s slot Gen2 x16, velocidade bidirecional — 16 GB/s
PCI	32 bits, velocidade — 33 MHz
SATA 2.0	1,5 Gbps e 3,0 Gbps
USB 2.0	<ul style="list-style-type: none"> alta velocidade — 480 Mbps

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • velocidade máxima — 12 Mbps • baixa velocidade — 1,2 Mbps |
|--|--|

[Voltar ao topo](#)

Video

Discreto	placa PCI Express x16
----------	-----------------------

[Voltar ao topo](#)

Áudio

Tipo	integrado de 7.1 canais, High Definition Audio (HDA) com suporte a S/PDIF
------	---

[Voltar ao topo](#)

Leitor de placa de memória

Placas compatíveis	<ul style="list-style-type: none"> • CompactFlash (CF) • Smart Media (SM) • xD-Picture (xD) • Memory Stick (MS) • Memory Stick PRO (MSPRO) • Memory Stick PRO HG (MSPRO HG) • SecureDigital (SD) • SecureDigital Card (SDHC) 2.0 • MultiMedia Card (MMC) • MicroDrive (MD)
--------------------	--

[Voltar ao topo](#)

Conectores da placa de sistema

Memória	quatro conectores de 240 pinos
PCI	um conector de 124 pinos
PCI Express x1	dois conectores de 36 pinos
PCI Express x16	um conector de 164 pinos
Alimentação (placa de sistema)	um conector EPS de 12 V de 24 pinos (compatível com ATX)
Ventilador do processador	um conector de 4 pinos
Ventilador do chassi	um conector de 3 pinos

Conector USB frontal	cinco conectores de 9 pinos
Conector de áudio frontal	um conector de 9 pinos para som estéreo em 2 canais e microfone
SATA	quatro conectores de 7 pinos
Saída S/PDIF	conector de 5 pinos

[Voltar ao topo](#)

Conectores externos

Adaptador de rede	conector RJ45
USB	dois conectores no painel superior, dois conectores no painel frontal e quatro conectores no painel traseiro, compatíveis com USB 2.0
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> • painel superior - conectores de fone de ouvido e de microfone • painel traseiro - seis conectores para suporte a 7.1
S/PDIF	um conector S/PDIF (óptico)
eSATA	um conector no painel traseiro
IEEE 1394a	um conector serial de 6 pinos no painel traseiro

[Voltar ao topo](#)

Slots de expansão

PCI	
Conectores	um
Tamanho do conector	conector de 124 pinos
Largura de dados do conector (máxima)	32 bits
PCI Express x1	
Conectores	dois
Tamanho do conector	conector de 36 pinos
Largura de dados do conector (máxima)	1 trilha PCI Express
PCI Express x16	
Conectores	um
Tamanho do conector	conector de 164 pinos
Largura de dados do conector (máxima)	16 trilhas PCI Express

[Voltar ao topo](#)

Alimentação

Fonte de alimentação de CC	
Potência	350 W
Máxima dissipação de calor	1836 BTU/h
NOTA: a dissipação de calor é calculada com o uso da potência nominal da fonte de alimentação.	
Tensão de entrada	115/230 VCA
Frequência de entrada	50/60 Hz
Corrente de saída nominal	8 A/4 A
Bateria de célula tipo moeda	célula tipo moeda de lítio de 3 V CR2032

[Voltar ao topo](#)

Bateria

Bateria de célula tipo moeda	célula tipo moeda de lítio de 3 V CR2032
------------------------------	--

[Voltar ao topo](#)

Características físicas

Altura	407,75 mm (16,02 polegadas)
Largura	185,81 mm (7,31 polegadas)
Profundidade	454,67 mm (17,90 polegadas)
Peso	10,18 kg (22,40 lb)

[Voltar ao topo](#)

Ambiente do computador

Faixa de temperatura:	
Operação	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa	20% a 80% (sem condensação)
Vibração máxima (usando um espectro de vibração aleatória que simula o ambiente do usuário):	
Operação	0,25 GRMS

Armazenamento	2,2 GRMS
Choque máximo (medido com disco rígido com cabeçote estacionado e um pulso de meia senóide de 2 ms):	
Operação	pulso de meia senóide: 40 G para 2 ms com uma variação de velocidade de 51 cm/s (20 pol/s)
Armazenamento	pulso de meia senóide: 50 G para 26 ms com uma variação de velocidade de 813 cm/s (320 pol/s)
Altitude (máxima):	
Operação	-15,2 a 3048 m (-50 a 10.000 ft)
Armazenamento	-15,2 a 10.668 m (-50 a 35.000 ft)
Nível de poluente aerotransportado	G2 ou inferior como definido pela ISA-S71.04-1985

[Voltar ao topo](#)